

Title (en)

PROCESS FOR REMOVING POLYACETAL BINDER FROM MOLDED CERAMIC GREEN BODIES.

Title (de)

VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON POLYACETALBINDEMITTELN AUS KERAMISCHEN GRÜNKÖRPERN.

Title (fr)

PROCEDE D'ELIMINATION DE LIANTS EN POLYACETAL CONTENUS DANS DES CORPS MOULES VERTS EN CERAMIQUE.

Publication

EP 0500682 A1 19920902 (EN)

Application

EP 90916894 A 19901022

Priority

- US 9006069 W 19901022
- US 43628989 A 19891113

Abstract (en)

[origin: WO9107364A1] A polyacetal binder is removed from an extruded or injection molded ceramic green body in less than 25 hours by a variable heating rate schedule in which the heating rate is reduced when the temperature of the green body reaches the point at which isothermal degradation of the polyacetal binder can take place and wherein at least 80 wt. % of the binder can be removed. In air, the isothermal removal of binder can take place within the range of 160-220 C while in nitrogen the range is from about 300-360 C.

Abstract (fr)

Un liant en polyacétal est éliminé d'un corps vert en céramique moulé par extrusion ou par injection en moins de 25 heures par un programme à vitesse variable de chauffage, selon lequel la vitesse de chauffage est réduite lorsque la température du corps vert atteint le point où la dégradation isothermique du liant en polyacétal peut se produire et où au moins 80 % en poids du liant peut être éliminé. Dans l'air, l'élimination isothermique du liant peut se produire sans une plage de températures comprises entre 160 et 220 °C, alors que dans de l'azote, la plage s'étend entre 300 et 360 °C.

IPC 1-7

B22F 3/24; **C04B 41/91**

IPC 8 full level

B22F 3/10 (2006.01); **C04B 35/634** (2006.01); **C04B 35/638** (2006.01); **C04B 41/91** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C04B 35/634 (2013.01 - EP US); **C04B 35/6342** (2013.01 - EP US); **C04B 35/638** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

WO 9107364 A1 19910530; CA 2067774 A1 19910514; CA 2067774 C 20020604; DE 69016043 D1 19950223; DE 69016043 T2 19950803; EP 0500682 A1 19920902; EP 0500682 A4 19930224; EP 0500682 B1 19950111; JP 3439759 B2 20030825; JP H05501536 A 19930325; US 5080846 A 19920114

DOCDB simple family (application)

US 9006069 W 19901022; CA 2067774 A 19901022; DE 69016043 T 19901022; EP 90916894 A 19901022; JP 51562990 A 19901022; US 43628989 A 19891113